

FINEPLACER® lambda 2

サブミクロン対応 高精度ダイボンディング装置

究極の光学デバイスアセンブリ用途

- ≫ サブミクロン実装精度
- ≫ 極めて優れた光学分解能
- ≫ 費用対効果の高い装置構成



各種の実装プロセスに対応
(接着剤・はんだ・熱圧着・超音波)

タッチスクリーン操作による全てのプロセスへの
アクセスと容易な視覚的プログラミング

フルオートまたはセミオートを選択
可能な装置バリエーション

データ及びメディアでの
記録機能とレポート管理機能

広範囲に制御可能なボンディングフォース

プロセスモジュールによる個別構成

特長

1つのレシピでの複数の実装プロセスに対応
独自のFINEPLACER® シリーズの原理
固定式ビームスプリッターによるオーバーレイビジョンアライメントシステム(VAS)
実行中プロセスの観察
パラメータに関連付いた全てのプロセスの同期制御
将来に渡る機能拡張を可能にするモジュールプラットフォーム
ファインテックプラットフォームに採用されたプロセスモジュールの互換
定義済みパラメータによるシーケンス制御

利点

新しい技術アプローチを実装する為の柔軟性
高精度実装を簡易な方法で実現。 信頼性が高い装置稼働を実現。
チップと基板の高精度ビジュアルアライメント
迅速かつ容易なプロセス品質検証のための 目視によるリアルタイムプロセスフィードバック
最大限のプロセス管理と再現性
新たな用途技術要件に対応するための容易で 最速な機能拡張
確立されたプロセスパラメータをシステム間に横展開
直感的かつ分かりやすいプロセスフローによる適切な プロセス手順の構築

実装方式

» はんだ方式/共晶はんだ方式
» 熱圧着ボンディング
» 超音波/超音波熱圧着ボンディング
» 接着剤ボンディング
» 焼結法

アプリケーション

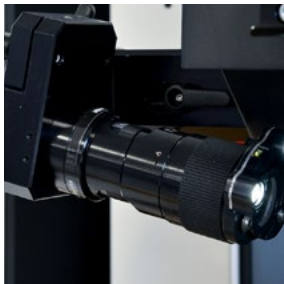
» レーザーダイオードアセンブリ
» レーザーダイオードバーアセンブリ
» VCSEL /フオダイオード(アレイ)アセンブリ
» レーザー(アレイ)アセンブリ
» 微小光学部品アセンブリ
» 微小光学ベンチアセンブリ
» 光学サブアセンブリ (TOSA/ROSA)
» イメージセンサーアセンブリ
» μ LED(アレイ)アセンブリ
» 汎用MOEMSアセンブリ
» 汎用MEMSアセンブリ
» ガス圧力センサーアセンブリ
» 加速度センサーアセンブリ

対応プロセス

» フリップチップボンディング(フェスダウン)
» 高精度ダイボンディング(フェスアップ)
» 3Dおよび2.5D ICパッケージング
» チップオンガラス (CoG)
» チップオンフレックス/フィルム (CoF)
» グラスオンガラス

モジュール及びオプション

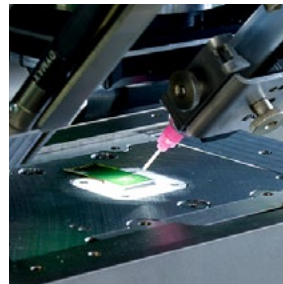
- » ボンディング荷重モジュール(自動)
- » ボンディング荷重モジュール(手動)
- » Y方向カメラシフト機能
- » チップ加熱モジュール
- » コンポーネント供給
- » ダイフリップモジュール
- » デispenserモジュール
- » デュアルカメラ光学系
- » ギ酸ガスモジュール
- » フォームジェネレータ
- » ギャップ調整モジュール
- » 高解像度光学系
- » デッピン/スタンピングモジュール
- » プロセスガスモジュール
- » プロセスガス選択
- » プロセスビデオモジュール
- » 基板加熱モジュール
- » 基板サポート
- » ツール交換モジュール
- » 超音波モジュール
- » UV硬化モジュール



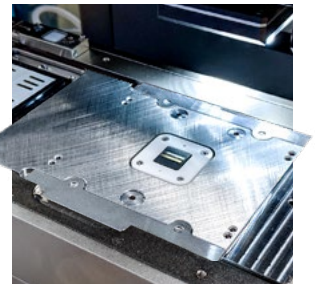
カメラモジュール



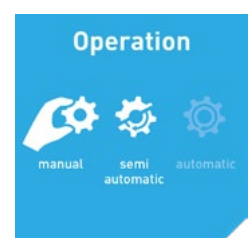
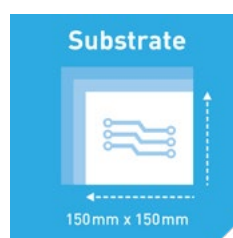
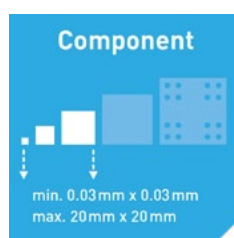
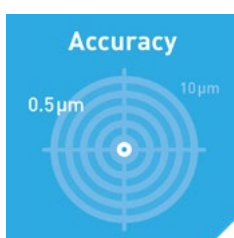
UV硬化モジュール



デispenserモジュール



基板加熱モジュール

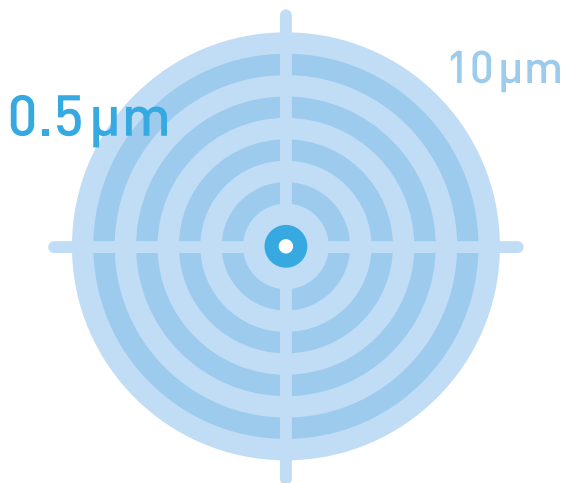


試作研究開発から量産へのシームレスな移行

これまであなたの有望な製品のアイデアは、開発から量産までの過程でどれだけ失われたでしょうか。ダイボンダーの技術的な制約や投資に対するターンが不透明なために実行に移せなかったのではないのでしょうか。生産要件に合わせて試作プロセスを自動化しようとして行き詰まったことはないのでしょうか。

ファインテックのPrototype-to-Production (プロトタイプからプロダクションまで) アプローチでは技術的な自由度を維持しながら研究開発から生産までのプロセスを1対1で確実に移行することができるため、市場投入までの時間を短縮し投資リスクを最小限に抑えることができます。

[資料のダウンロードはこちら:](#)



如何にして精度を測定するか

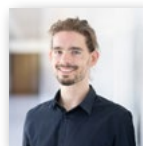
パッケージング技術のアセンブリシステムいわゆるダイボンダーではその搭載精度が装置性能の重要なキープポイントとなります。しかしその精度がどのような定義なのかまたそれをいつどのようにして測定するのかはしばしば明確ではありません。そのためファインテックでは、当社のダイボンディングシステムの精度がどのように定義され測定されているかについて透明性がありかつ検証可能な方法をご説明しています。このテクニカルペーパーでは精度の背景や影響要因を説明しファインテック製品や他のメーカーの製品の精度仕様からお客様がどのような結論を導き出すことができるかについて情報を提供します。

[資料のダウンロードはこちら:](#)



カスタマーフィードバック

"We use the FINEPLACER® lambda 2 for development processes on MEMS, e.g. for precise dispensing and the placement of microstructures. The system fits in with the investment strategy at ISS, where flexible facilities with a wide range of materials enable research into new materials and, in particular, rapid prototyping."



Severin Schweiger

Fraunhofer IPMS, Integrated Silicon Systems